

## 【大阪市内】3D CAD機械設計／半導体運搬装置の設計エンジニア（Junior Engineer／Osaka）

《油圧シリンダ国内トップシェア》90年以上の実績を誇る安定成長の外資系メーカー

### 募集職種

#### 採用企業名

株式会社Parker TAIYO

#### 求人ID

1572622

#### 部署名

--

#### 業種

機械

#### 会社の種類

大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

大阪府, 大阪市東淀川区

#### 最寄駅

京都本線、 相川駅

#### 給与

450万円～750万円

#### ボーナス

給与：ボーナス込み

#### 歩合給

給与：歩合給込み

#### 勤務時間

8:30～17:05

#### 休日・休暇

土日祝日、GW・夏季・年末年始休暇（会社カレンダーあり・年1日程度土曜出勤日あり）

#### 更新日

2026年02月17日 00:00

### 応募必要条件

#### 職務経験

1年以上

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

無し

#### 日本語レベル

ビジネス会話レベル

#### 最終学歴

専門学校卒

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

## 募集要項

半導体ウェハー搬送装置の3D CADを使用した設計業務を担当いただきます。

◎主な業務：仕様設計、詳細設計、設計変更提案、図面の確認、関係部門や顧客との折衝・調整など

◎使用CAD：iCAD

年に数回客先への出張があります。

---

## スキル・資格

- ・ 3D CADでの機械設計経験（使用CAD不問）
- ・ 日本語ネイティブレベル

---

## 会社説明